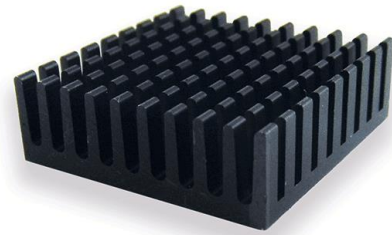


Produkt Datenblatt Typ: PG3030/10/SE/SF

Gruppe: Kühlkörper PCB Montage

Für Einzelmontage

Breite :	30 mm
Höhe :	10 mm
Länge :	30 mm
Minimaler Wärmewiderstand :	9,6 K/W
Für Halbleitergehäuse :	PGA BGA IC
Halbleitermontage :	Kleben
Kühlkörpermontage :	Kleben
Oberfläche :	Schwarz eloxiert
Material :	AlMgSi0,5



- Kühlkörper für Mikroprozessoren (Strangpresstechnik)
- Direktmontage durch Selbstklebefolie (vormontiert)
- Bestmögliche Wärmeabstrahlung durch schwarz eloxierte Oberfläche
- Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz
- gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung
- für erzwungene und freie Konvektion geeignet
- RthK- Werte gelten für natürliche Konvektion (ohne Fremdbelüftung)
- Aluminiumlegierung: Al MgSi 0,5
- Wärmeleitwert: 180-200 W/mK
- kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage.

